



熱可塑性半導電性コンパウンド

	密度	MFR (211.8N)	引張強さ	切断時 伸び	体積固有 抵抗 23℃	カーボン	ベース 樹脂				用途	特長
単位	g/cm3	g/10min	MPa	%	ohm.cm	-	-					
銘柄												
NUC-9511	1.16	12	> 9	> 100	< 30	アセチレン BK	EEA				導電性を必要とするケーブル、各種成形品、半導電性架橋コンパウンド押出のスタートアップ・シャットダウン樹脂	押出のほか、各種成形が可能。ポリエチレン層との密着性が良好である。カーボンブラックの分散状態が良好なため、押出した半導電層の表面が非常に平滑である。

注) 本カタログの数値は代表的な値を示したものでありますから、本材料使用上の手引きとしてのみご使用下さい。

接着性半導電性コンパウンド

	密度	MFR (21.18N)	融点 (DSC法)	引張破壊 応力	引張破壊 伸び	デュロメータ 硬さ	ピカット 軟化温度	剥離強度	体積固有 抵抗 23℃	ベース 樹脂	用途	特長
単位	g/cm3	g/10min	℃	MPa	%	HDD	℃	N/cm	ohm.cm	-		
銘柄												
GA-004BK	1.00	40	126	17	710	57	88	19	45	LLDPE	導電性と接着性を必要とする各種成形品、電力ケーブルの遮水テープ等の絶縁保護用途	良好な導電性を有している。金属や他のプラスチックとの接着が可能。良好なフィルム成形性がある。

注) 本カタログの数値は代表的な値を示したものでありますから、本材料使用上の手引きとしてのみご使用下さい。